



中华人民共和国国家标准

GB/T 14619—93

厚膜集成电路用氧化铝陶瓷基片

Alumina ceramic substrates for thick
film integrated circuits

1993-09-03 发布

1993-12-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

厚膜集成电路用氧化铝陶瓷基片

GB/T 14619—93

Alumina ceramic substrates for thick
film integrated circuits

1 主题内容与适用范围

本标准规定了厚膜集成电路用氧化铝陶瓷基片的结构尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于厚膜集成电路用氧化铝陶瓷基片,片状元件用氧化铝陶瓷基片亦可参照使用。(以下简称基片)。

2 引用标准

- GB 1031 表面粗糙度参数及其数值
- GB 1958 形状和位置公差 检测规定
- GB/T 2413 压电陶瓷材料体积密度测量方法
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)
- GB 5592 电子元器件结构陶瓷材料的名称和牌号的命名方法
- GB 5593 电子元器件结构陶瓷材料
- GB 5594.3 电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 平均线膨胀系数测试方法
- GB 5594.4 电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 介质损耗角正切值的测试方法
- GB 5594.5 电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 体积电阻率测试方法
- GB 5598 氧化铍瓷导热系数测定方法
- GB 9531 电子陶瓷零件通用技术条件

3 结构尺寸

3.1 基片的长、宽、厚和最小孔尺寸列于表1。

表 1

mm

长×宽	厚度	最小孔尺寸
≤152×152的所有尺寸	0.3~1.5	最小直径 $\phi 0.25$ 最小边长 0.40

3.2 相邻两孔之间的壁厚或边与孔间距离不小于基片的厚度,且不小于 0.5 mm。